

越南半導體產業求才若渴，不僅限於 IC 設計領域

駐胡志明市辦事處教育組

於 2025 年 7 月 18 日，由臺灣大葉大學與胡志明市國際高專（Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM）共同舉行之「半導體科技產業培訓計畫移交儀式」上，胡志明市國際高專校長阮登李（Nguyễn Đăng Lý）表示，「在半導體產業中，若晶片設計只需要 1 位人力，生產、封裝與測試等環節則需 2 至 5 位人力。這些環節對人才的需求量龐大，卻未獲得足夠的重視培育。」

阮校長援引美國半導體產業協會（SIA）的統計指出，美國半導體產業預計到 2030 年將面臨約 6.7 萬名專業人才的短缺。而韓國每年也同樣缺乏數萬名相關技術人力。

大葉大學工學院院長李清華表示，目前全球對半導體領域的人才需求正處於高峰期，僅台灣每年就需要數萬名專業人力投入該產業。大葉大學國際事務中心主任盧炫綸也指出，不僅是臺灣，全球多個國家與地區也正面臨半導體人才的嚴重短缺。臺灣正積極投入人才培訓，培養具備即戰力的半導體工程師，以支援包括越南在內的多國產業發展需求。

在越南方面，政府於 2024 年 9 月正式核准「半導體產業人力資源開發至 2030 年，並展望 2050 年」計畫之政策目標，力求至 2030 年前培育至少 5 萬名具大學以上學歷的半導體產業人才。根據該計畫，越南將著重於不同領域的人才培養，其中包括：設計領域至少 1.5 萬人，生產、封裝、測試以及其他製程相關領域則需培訓至少 3.5 萬人，以全面支撐半導體產業鏈的發展需求。

然而，胡志明市國際高專阮校長指出，目前全國每年僅有約 1,000 名大學生接受有關半導體晶片設計的專業培訓，而幾乎沒有任何高專院校開設與生產、封裝與測試等後段製程相關的人才培育課程。他強調：「若晶片設計僅需 1 位工程師，生產、封裝與測試等後段環節則需要 2 至 5 位的工程師。這些領域對人才的需求極為龐大，卻未獲得足夠重視與系統性培訓。」

碩士阮登李（Nguyễn Đăng Lý）表示，為滿足社會對半導體產業專業人力的迫切需求，胡志明市國際高專已與台灣大葉大學簽署合作協議，轉移半導體科技相關的培訓課程與教學資源。

該校的半導體培訓課程將採用「2+2」學制模式。學生將在越南學習兩年，之後轉至臺灣大葉大學繼續完成學業。值得一提的是，參與此課程的學生可獲得全額獎學金（INTENSE 獎學金）。

阮校長表示：「學生可先在校內選擇四個專業之一，包括電腦程式設計、網路管理、汽車技術及工業電機，完成基礎課程後，再轉至臺灣專攻半導體領域。」而轉學至臺灣繼續就讀的條件則為學生必須達到華語文能力測驗（TOCFL）A2 級別，且華語培訓課程免費提供。

大葉大學國際事務中心主任盧炫綸表示，該校在培訓過程中採取理論與實務並重的教學方式，並配備先進的實驗室與設備，特別強調與業界標準高度接軌，讓學生能夠在實際操作中貼近產業需求。「畢業後，學生可擔任半導體工程師，從事封裝、測試、產品開發、電子工程或材料研發等多元職務，具備良好的就業競爭力。」

撰稿人/譯稿人：陳和賢

資料來源：2025 年 7 月 18 日，青年電子報；

<https://thanhvien.vn/khat-nhan-luc-nganh-ban-dan-khong-chi-voi-thiet-ke-vi-mach-18525071820392804.htm>